

元器件可焊性测试

产品名称	元器件可焊性测试
公司名称	江苏江测检测技术服务有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市新吴区弘毅路6号
联系电话	18605102423

产品详情

可焊性测试，英文是“Solderability”。指通过润湿平衡法（wetting balance）这一原理对元器件、PCB板、PAD、焊料和助焊剂等的可焊接性能做一定性和定量的评估。对现代电子工业的1级（IC封装）和2级（电子元器件组装到印刷线路板）的工艺都需要高质量的互通连接技术，以及高质量和零缺陷的焊接工艺有极大的帮助。

事实上对可焊性的评估，国际上各大标准组织IEC，IPC，DIN，JIS等推荐了各种方法，但是无论从试验的重复性和结果的易于解读性，润湿平衡法（wetting balance）都是目前公认的进行定性和定量分析的可焊性测试方法。

在锡焊的过程中将焊料、焊件与铜箔在焊接热的作用下，焊件与铜箔不熔化，焊料熔化并湿润焊接面，从而引起焊料金属的扩散形成在铜箔与焊件之间的金属附着层，并使铜箔与焊件连接在一起，就得到牢固可靠的焊接点，以上过程为相互间的物理作用过程的效果。

焊性测试一般是用于对元器件、印制电路板、焊料和助焊剂等的可焊接性能做一个定性和定量的评估。

在电子产品的装配焊接工艺中，焊接质量直接影响整机的质量。因此，为了提高焊接质量，除了严格控制工艺参数外，还需要对印制电路板和电子元器件进行科学的可焊性测试。

通过实施可焊性测试，帮助企业确定生产装配后的可焊性的好坏和产品的质量优劣。微谱技术在实践操作中，进一步丰富了对印制电路板等元器件的可焊性测试技术手段，明确了影响可焊接性的内在因素，对制造业的技术工程师提高产品质量和零缺陷的焊接工艺给予了极大的帮助。

品分为 1) 有铅 2) 无铅

- 参考标准：
- Edge dip test 浸锡:J-STD-003 TEST A(铅锡)/J-STD-003 TEST A1(无铅)
- Solder float test 浮锡:J-STD-003 TEST C(铅锡)/J-STD TEST C1(无铅)

- Wave solder test 波峰焊:J-STD-003 TEST D
- Wetting Balance(湿润平衡): J-STD-003 TEST F(铅锡)/J-STD-003 TEST F1(无铅)
- Solderability for Metallic Surface(金属表面可焊性):IPC-TM-650 2.4.14

J-STD-002B 2003-2 元件、接线片、端子可焊性测试

J-STD-003B (2007-3) 印刷电路板可焊性测试

IPC-TM-650 2.4.14金属表面可焊性

IPC-TM-650 2.6.8 热应力试验

GB/T 4677 印制板测试方法

IEC60068-2-58/ IEC60068-2-20 可焊性及热应力试验

GB2423.28电工电子产品基本环境试验规程

GB2423.32电工电子产品基本环境试验规程

MIL-STD-202G 方法208H 可焊性试验

MIL-STD-202G Mehtod 210F 热应力试验

MIL-STD-883G 2003.7 可焊性试验